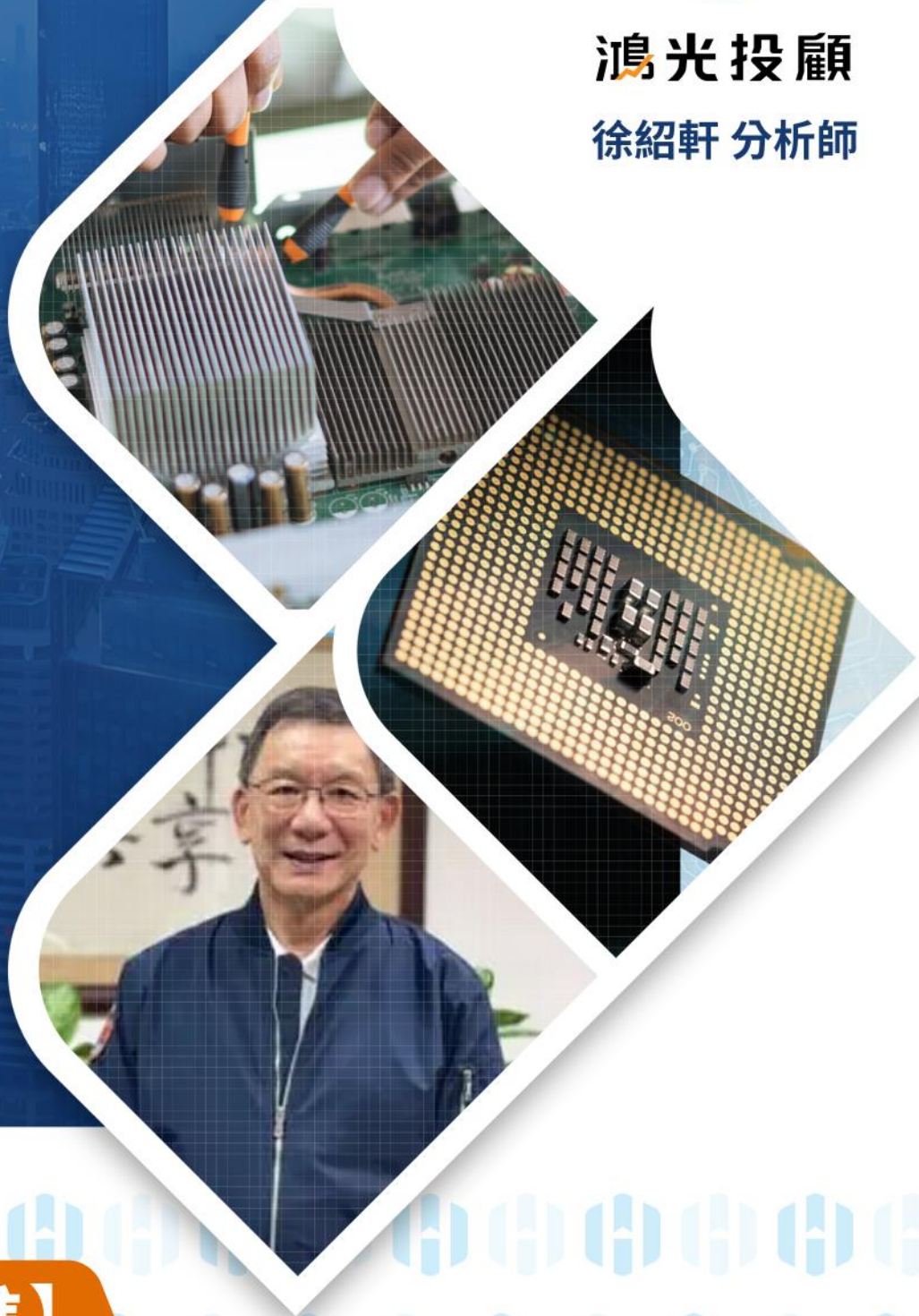


3167 大量

- 基本資料
- 公司介紹
- 展望2024



鴻光投顧
徐紹軒 分析師



★ 評等【買進】

CoWoS 設備即將出貨

大量 3167

營收組成

PCB及半導體設備 **87.98%**

其他 **12.02%**

籌碼分布

董監持股比率 **14.07%**

外資持股比率 **4.95%**

投信持股比率 **0%**

自營商持股比率 **0.43%**

融資餘額比率 **6.76%**

融券餘額比率 **0.26%**

2024年EPS **0.16元**

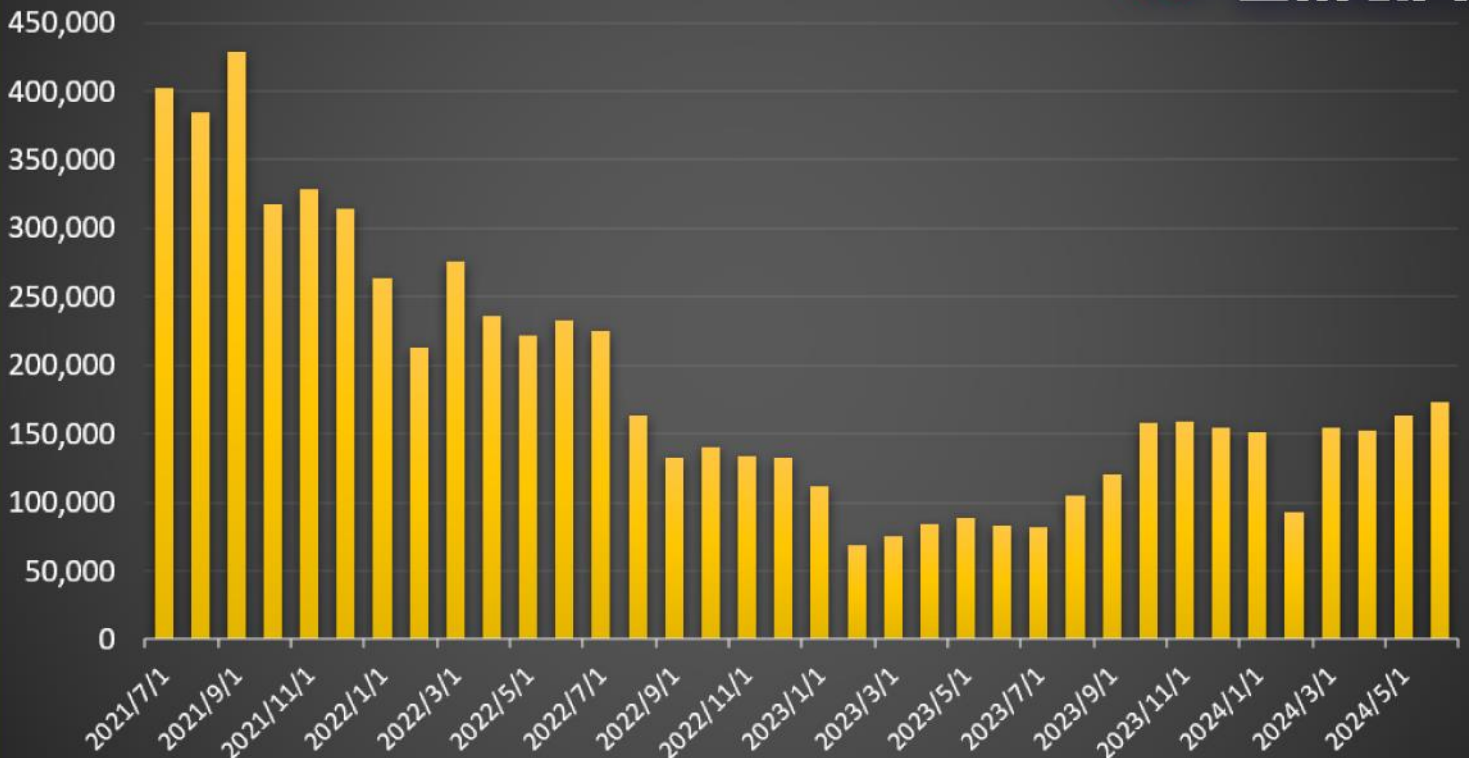
公司介紹

大量(3167)，是台灣一家專注於半導體產業、印刷電路板(PCB)產業及光電面板產業的智能設備製造商。公司擁有完整的機械設計開發、製造組裝、品質測試、銷售服務及財務管理體系，致力於為客戶提供完善的設備及系統性服務，主要業務包括各種機器和模具的設計、製造、加工及買賣，並涉及相關業務的進出口貿易。公司總部位於桃園市八德區，並且在國內外有多家合作夥伴。

大量 3167

營運表現

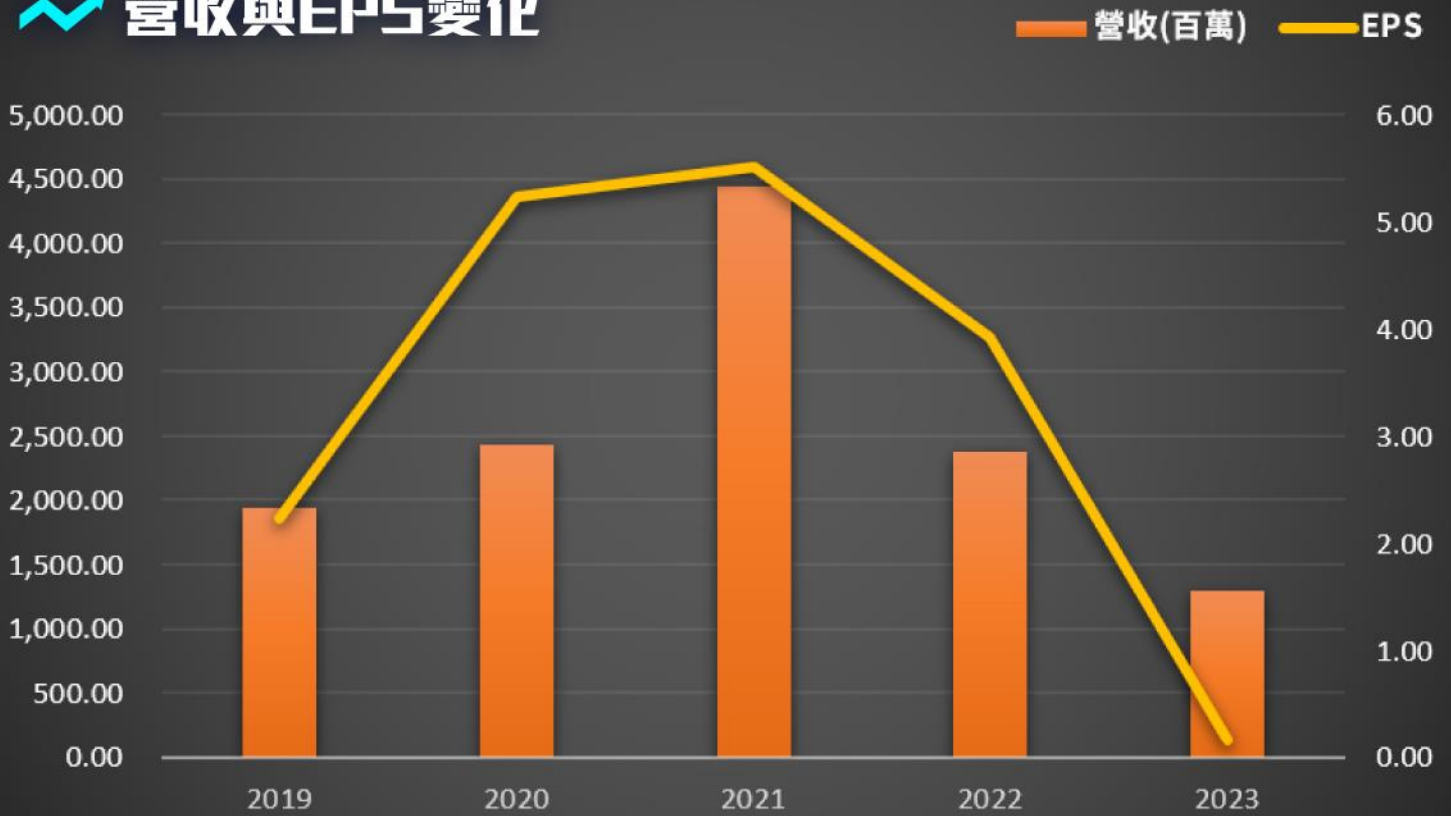
營業收入



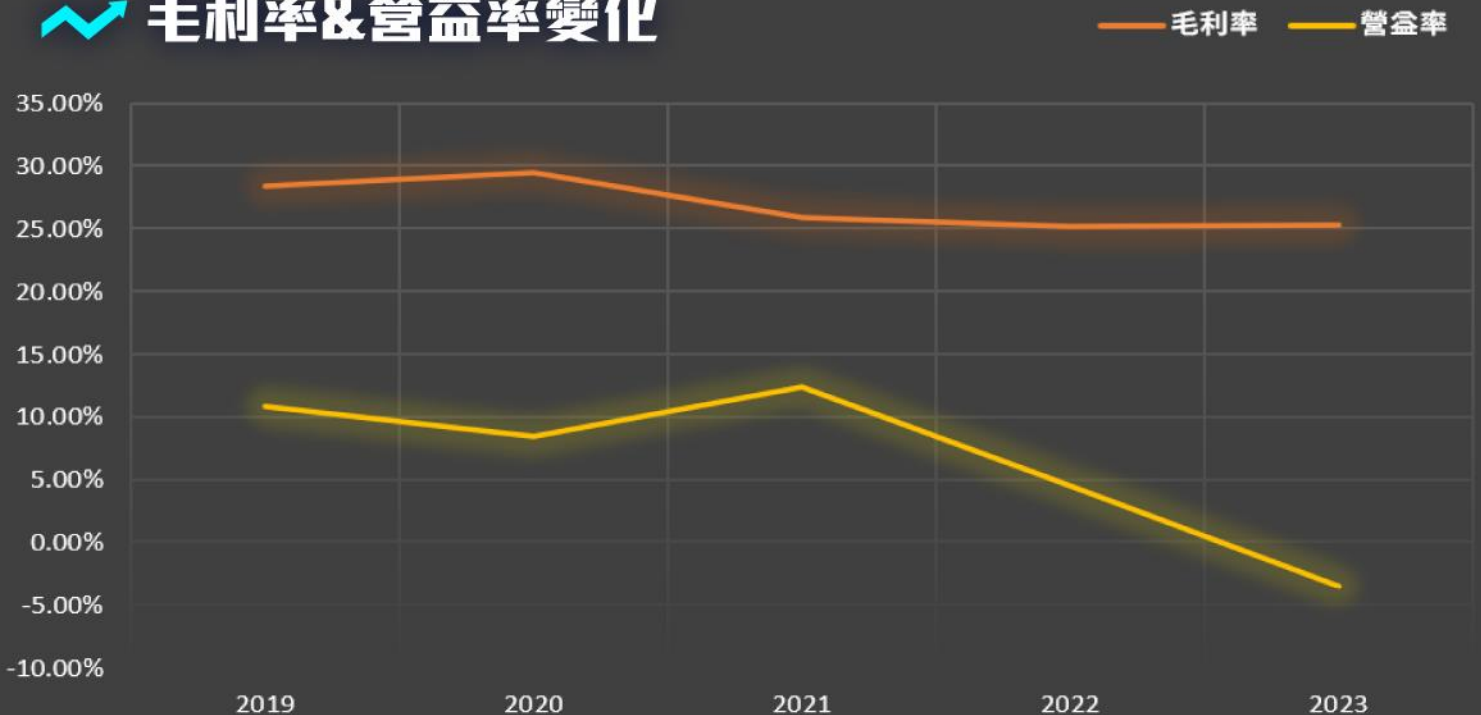
年度	營收(百萬)	銷售成本	營業利益	毛利率	營益率	業外利益	EPS
2019	1,942.64	1,390.77	209.65	28.41%	10.79%	64.19	2.22
2020	2,427.61	1,711.54	202.82	29.50%	8.35%	256.64	5.23
2021	4,443.51	3,293.56	550.88	25.88%	12.40%	16.32	5.51
2022	2,370.25	1,774.35	106.60	25.14%	4.50%	252.39	3.91
2023	1,292.28	965.09	(46.20)	25.32%	-3.58%	17.47	0.16

大量 3167

營收與EPS變化



毛利率&營益率變化



 展望2024

2024年，大量科技在營運方面呈現顯著成長。第一季度的營收達到3.98億元，儘管稅後虧損1605萬元，每股虧損0.19元，但法人預估第二季度開始，公司的營運將轉為盈餘，下半年，大量科技將與群翊合作，爭取大型半導體客戶的新訂單，預計這將為營收帶來新的增長動力，並有望在下半年進一步擴大獲利。

在先進封裝技術方面，大量科技積極參與COWOS相關設備的市場。2024年，隨著高階AI應用的需求不斷增加，COWOS技術的市場需求也在快速增長。台灣的供應鏈，包括大量科技在內，正在擴大其在這一領域的布局和產能。

總的來說，大量科技在2024年的展望十分樂觀，尤其是在半導體和PCB設備方面的表現令人期待。公司與群翊的合作以及在先進封裝技術上的進展，將成為未來營收增長的主要驅動力。

免責 宣言

本公司與推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係。本研究報告僅提供投資人參考，且純粹屬於研究性質，並不保證報告內容的完整性與準確性，亦無任何影響投資買賣決定，報告中的各項意見與預測，均為公司參考資訊彙整，受到特定的判斷日期之時效性限制，所有資訊及預估，變更時本公司將不作預告更新，相關資訊請依「公開資訊觀測站」為主，本研究報告內容僅供參考，投資人任何投資決策，需自行謹慎評估相關風險，並就投資結果自行負責。